

明細書

半導体素子の接続構造、その構造を用いた液晶表示装置及びそれを用いた電子機器

[技術分野]

本発明は、基板上に半導体素子を接続するための半導体素子の接続構造、その構造を用いた液晶表示装置及びその液晶表示装置を使用した電子機器に関する。

[背景技術]

近年、ナビゲーションシステム、テレビ、パームトップコンピュータ、電子手帳、携帯電話機等といった各種の電子機器において、可視情報を表示するために液晶表示装置が広く用いられている。この液晶表示装置は、一般に、液晶パネルに液晶駆動用ICすなわち半導体素子を接続し、さらにその液晶パネルにバックライト、ケーシング等といった付帯部品を装着することによって構成される。ここにいう液晶パネルは、通常、少なくとも2枚の液晶用基板によって挟まれた間に液晶を充填し、必要に応じてさらに、偏光板、カラーフィルタ等を装着することによって構成される。

液晶駆動用ICを液晶パネルに接続する方法としては、従来より種々考えられており、例えば、COB (Chip On Board) 方式やCOG (Chip On Glass) 方式等に基づいた接続方法が考えられる。COB方式では、配線パターンを形成した絶縁基板上にACF (Anisotropic conductive film) その他の接合剤を用いて液晶駆動用ICを接続し、その絶縁基板をヒートシール等を介して液晶パネルに接続する。

一方、COG方式では、電極端子が形成されたガラス基板上にACF等を用いて液晶駆動用ICを直接に接続する。COB方式及びCOG方式のいずれの場合でも、液晶駆動用IC等の半導体素子は、絶縁基板や液晶用ガラス基板等といった基板上に接続される。

上記従来の接続方法では、基板と液晶駆動用ICとの間にACFその他の接合剤が空隙無く均一に充填されていた。そのため、液晶駆動用ICを圧着するときにそのICに反りが生じたり、温度変化に起因して液晶駆動用IC及び／又は基板が変形するとき、基板上の電極に接触する液晶駆動用ICのバンプ部分に過剰

な応力が発生し、その結果、電気接続状態が不安定になるおそれがあった。また、そのような問題の発生を回避するためには、液晶駆動用ICの圧着条件を狭い許容範囲内で厳しく管理しなければならず、従って、複雑な工程管理を要求されていた。

また、特開平2-42738号公報によれば、COB実装プリント回路板においてICチップと基板との間に緩衝層としての柔軟性接着剤層を設けることにより、両者の間の接合信頼性を向上させた接続構造も開示されている。しかしながら、この従来の接続構造では、緩衝作用を得るために専用の柔軟性接着層を形成しなければならず、部品コスト及び製造コストが高くなるという問題があった。

本発明は、半導体素子の接続構造における従来の問題点に鑑みて成されたものであって、極めて簡単な構成を付加するだけで、基板に対する半導体素子の接続状態を安定に保持できるようにすることを目的とする。

[発明の開示]

本発明は上記の目的を達成するため、本発明に係る半導体素子の接続構造は、基板上に半導体素子を接続する半導体素子の接続構造において、基板上に半導体素子を接続する半導体素子の接続構造において、基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層を有しており、その接着層は、基板と半導体素子とを接合する接合剤と、その接合剤の内部に形成された空間とを有することを特徴とする。

この接続構造によれば、半導体素子と基板とを接合するときに、接合剤の中にあえて空間を形成することにより、基板もしくは半導体素子の変形に対応して空間が自由に変形して半導体素子等の変形を吸収する。その結果、半導体素子又は基板が変形する場合でも半導体素子の電極部分に過剰な負荷が加わることを防止でき、よって、半導体素子の電気接続状態を安定した良好な状態に保持できる。

空間は、後述するように加圧ヘッドでICを加圧し、同時に加熱することにより接合剤の中に形成される。加圧ヘッドの温度が接着剤に加わった際に、接着剤の粘度が急激に低下し、そして外へ流れ出すことにより、空間を形成することができる。このように、接着剤の中にあえて空間を形成することにより、半導体素

子もしくは基板に加わる変形を緩和させることができる。

上記構成において、半導体素子としては I C チップ、 L S I チップ等の素子が考えられる。また、液晶表示装置を想定する場合には、半導体素子として液晶駆動用 I C 等が考えられる。また、基板としては、 C O B 方式の場合の絶縁基板、 C O G 方式の場合の液晶用透明基板、その他各種の接続方法に対応した各種の基板が考えられる。また、接合剤としては、 A C F (Anisotropic conductive film : 異方性導電膜) や通常の接着剤等が考えられる。

A C F というのは、熱可塑性樹脂フィルム又は熱硬化性樹脂フィルムの中に導電粒子を分散させたもので、熱圧着を受けることによって单一方向への導電性を発揮するような接合剤である。

一方、通常の接着剤とは、主に基板と半導体素子とを機械的に接合させるだけで、電気的な接続の役割は持たない接着剤である。

A C F を用いる場合は、基板上の端子と半導体素子のバンプとが A C F 内の導電粒子を介して電気的に接続される。一方、通常の接着剤を用いる場合は、基板上の端子と半導体素子のバンプとが直接に接続されて電気的な導通がとられ、その状態において通常の接着剤によって半導体素子が基板に機械的に接着される。

半導体素子として液晶表示装置に使われる液晶駆動用 I C を考えると、その液晶駆動用 I C の能動面には複数のバンプが列状に並べられる。この列状の態様としては種々考えられるが、例えば第 2 図及び第 7 図に示すように、長手方向に列状(図では 2 列)に並べられた一対のバンプ列 2 8 , 2 9 と、短手方向に列状(図では 2 列)に並べられた一対のバンプ列 2 8 , 2 8 とによって環状に配列されることがある。また、第 8 図に示すように、長手方向又は短手方向に関してだけ一対のバンプ列 2 8 , 2 9 が設けられることもある。

以上のようなバンプ配列を有する半導体素子を基板上に接続する際には、第 2 図に示すように、環状のバンプによって囲まれる領域内の接合剤の中に空間 3 3 を形成したり、第 7 図に示すように、個々のバンプ 2 8 , 2 9 の間やバンプ列の外側に空間 3 3 を形成したりすることができる。

接合剤の内部に形成される空間は、容積の大きい单一の空間であっても良いし、あるいは、容積の小さい複数の空間を互いに近接して配置することによって形成

された空間であっても良い。

なお、接着剤中に占める空間の割合が5%～70%であることが好ましく、より好ましくは10%～30%であることが好ましい。これは、空間の割合が5%未満の場合、半導体素子もしくは基板に係る変形（もしくは応力）を吸収することができないためであり、逆に70%を越えた場合、半導体素子と基板（特に基板に形成された端子）とを接続するに信頼性が低下するためである。少なくとも5%～70%の間で空間を設定したことにより、接続信頼性は確保できるものの、より好ましくは10%～30%の間に空間の割合を設定することにより、接続信頼性が向上した構造が得られる。

なお、接着層がエポキシ系の接着剤からなる。そして、その接着層は、半導体素子又は基板の変形を吸収する作用を有する

また、本発明の半導体素子の接続方法は、基板上に半導体素子を接続する半導体素子の接続方法において、基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層を介在させ、高温に加熱された加圧ヘッドで前記半導体素子を押し付けることにより前記接着層を加圧及び加熱し、前記基板と半導体素子とを接続するとともに、前記接着層の中に空間を形成することを特徴とする。このような構成とすることにより、半導体素子もしくは基板に係る変形を空間により緩和することができ、信頼性の向上した接続構造を得ることができる。なお、接着層がエポキシ系の接着剤からなることを特徴とする。

本発明に係る液晶表示装置は、以上に説明した半導体素子の接続構造を用いて構成される液晶表示装置である。より具体的には、本発明に係る液晶表示装置は、液晶を挟んで互いに対向する一対の液晶用基板と、少なくとも一方の液晶用基板上に接続される半導体素子と、液晶用基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層とを有する液晶表示装置であって、その接着層が、液晶用基板と半導体素子とを接合する接合剤と、その接合剤の内部に形成された空間とを有することを特徴とする。

前述のように、接着剤中に占める空間の割合が5%～70%、より好ましくは10%～30%の範囲に設定することにより半導体素子と基板に形成された電極端子とを信頼性高く接続することができる。

また、本発明に係る液晶表示装置を用いた電子機器は、例えばナビゲーションシステム、テレビ、パームトップコンピュータ、電子手帳、携帯電話機等といった各種の機器が具体例として考えられる。より具体的には、複数の半導体駆動用出力端子と、それらの半導体駆動用出力端子に接続される液晶表示装置と、入力装置などを有する電子機器であって、その液晶表示装置は、液晶を挟んで互いに対向する一対の液晶用基板と、少なくとも一方の液晶用基板上に接続される半導体素子と、液晶用基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層とを有する。そして、その接着層は液晶用基板と半導体素子とを接合する接合剤と、その接合剤の内部に形成された空間とを有する。

[図面の簡単な説明]

第1図は、本発明に係る半導体素子の接続構造の一実施形態を示す断面図である。第2図は、第1図における矢印Aに従って半導体素子の接合部分を示す平面図である。

第3図は、本発明に係る液晶表示装置の一実施形態を示す側面断面図である。

第4図は、第3図の液晶表示装置の分解斜視図である。

第5図は、電子機器内で液晶表示装置と他の回路を電気的に接続するための弾性体コネクタの一例を示す斜視図である。

第6図は、本発明に係る電子機器の一実施形態である携帯電話機を示す分解斜視図である。

第7図は、接合剤の中に設ける空間の設け方の変形例を示す平面図である。

第8図は、半導体素子のバンプ配列の変形例を示す平面図である。

[発明を実施するための最良の形態]

第6図は、本発明に係る液晶表示装置を用いた電子機器の一実施形態であり、携帯電話機の一例を示している。この携帯電話機は、上部筐体1及び下部筐体2を有する。上部筐体1の中には、キーボード10等を制御するためのP C B (Printed Circuit Board) 等が含まれる。また、下部筐体2の中には、コントロール用LSI等を搭載した制御回路基板3及びその回路基

板3を搭載した本体基板4が収納される。本体基板4の上には本発明に係る液晶表示装置5が装着される。本体基板4の表面には、複数の半導体駆動用出力端子6が配線パターンとして形成されている。液晶表示装置5はその内部に液晶駆動用IC7、すなわち半導体素子を有しており、液晶表示装置5を本体基板4の上に装着した状態で液晶駆動用IC7が半導体駆動用出力端子6に電気的に接続される。下部筐体2の中に液晶表示装置5その他の必要機器を配設し、その後、上部筐体1を上方から被せることにより携帯電話機が完成する。なお、符号20はスピーカを示している。

液晶表示装置5は、例えば第4図に示すように、液晶パネル8、バックライトユニット9、シールドケース11及び弾性体コネクタ12を有する。液晶パネル8は、第3図に示すように、透明なガラスによって形成された第1液晶用基板13及び同じく透明なガラスによって形成された第2液晶用基板14を有する。第1液晶用基板13の内側表面には透明電極18が形成され、一方、第2液晶用基板14の内側表面には透明電極19が形成される。これらの電極は、いずれも、ITO(Indium Thin Oxide)その他の透明導電材料によって形成される。

第1液晶用基板13及び第2液晶用基板14のそれぞれの外側表面には、偏光手段として偏光板16a及び偏光板16bが貼り付けられる。第1液晶用基板13と第2液晶用基板14とは環状のシール剤17によって所定の間隙、いわゆるセルギャップをもって液密状態に接着される。そして、このセルギャップ内に液晶が封入される。第1液晶用基板13のうち第2液晶用基板14の外側(第3図の右側)に張り出す部分13aの内側表面の右端部には半導体入力用端子21が形成される。半導体素子としての液晶駆動用IC7は接着層31によって第1液晶用基板13の上に直接に接着され、これにより、IC7の出力用バング28が透明電極18に接続され、他方、IC7の入力用バング29が半導体入力用端子21に接続される。

このように本実施形態では、液晶駆動用IC7が液晶パネル8を構成する液晶用基板13の上に直接に接合される形式の液晶表示装置、すなわちCOG(Chip On Glass)型液晶表示装置が用いられている。

第3図において、バックライトユニット9は、導光体22及びその左端に固定された複数、例えば4個のLED (Light Emitting Diode : 発光ダイオード) 23を有する。導光体22の右端部には、第4図にも示すように、弾性体コネクタ12をガイドするための手段として作用する直方体形状のガイド穴24が形成される。このガイド穴24は、第3図に示すように、弾性体コネクタ12を隙間なく収納できる大きさに形成される。

弾性体コネクタ12は、第5図に示すように、電気絶縁性を備えた弾性材料、例えばシリコンゴムによって、断面半円形状の柱状に形成された弾性基部25と、その弾性基部25の半円状外周表面に互いに平行に設けられた多数の導電部26とを有する。互いに隣り合う2つの導電部26の間は弾性材料によって非導電部となっており、その非導電部の幅は、例えば $15\text{ }\mu\text{m} \sim 25\text{ }\mu\text{m}$ 程度に保持される。図中の符号Wは、互いに隣り合う導電部26間の間隔、いわゆる導電部間ピッチを示しており、通常は、 $W = 30\text{ }\mu\text{m} \sim 50\text{ }\mu\text{m}$ 程度に設定される。

本実施形態の液晶表示装置を携帯電話機(第6図)の本体基板4に装着する際には、第4図において、弾性体コネクタ12を導光体22のガイド穴24の中に挿入し、バックライトユニット9を本体基板4上の所定位置に置き、液晶パネル8をバックライトユニット9上の所定位置に置き、シリコンゴムその他の弾性体によって形成した加圧用部材30を間に入れた状態でシールドケース11を液晶パネル8及びバックライトユニット9の上に被せ、そして第3図に示すように、カシメ用ストッパ27を変形させることによって本体基板4とシールドケース11とを締め付けて固定する。

このとき、弾性体コネクタ12は加圧用部材30の働きによって第3図の上下方向に圧縮されて弾性変形し、その結果、導電部26(第5図参照)は、弾性基部25の弾性復元力によって、液晶パネル8側の半導体入力用端子21と本体基板4側の半導体駆動用出力端子6の両方にしっかりと接触する。

なお、弾性体コネクタ12を圧縮する方法に関しては、加圧用部材30のような専用の部品を用意するのに代えて、シールドケース11の対応する個所を内側へ突出するように変形させてシールドケース11の該部にリブを形成し、そのリブによって弾性体コネクタ12を圧縮することもできる。

以上により液晶表示装置の組み付けが完了すると、制御回路基板3（第6図）から半導体駆動用出力端子6、弹性体コネクタ12（第3図）及び半導体入力用端子21を通して液晶駆動用IC7へ電気信号及び液晶駆動用電力が供給され、それに基づいて液晶駆動用IC7によって電極18及び19への印加電圧が制御される。そして、この電圧制御により、液晶パネル8の有効表示領域に可視像が表示される。

本実施形態では、液晶パネル8側の半導体入力用端子21と携帯電話機側の半導体駆動用出力端子6との間に弹性体コネクタ12を配置するだけで両者を電気的に接続できるので、組立作業が非常に簡単である。また、弹性体コネクタ12をガイド穴24の中に配置したので、弹性体コネクタ12に力が加わったときにその弹性体コネクタ12が撓み、座屈などといった変形を生じることがなく、従って、半導体入力用端子21と半導体駆動用出力端子6との間の電気接続状態を常に安定状態に保持できる。

本実施形態では、第1図に示すように、液晶駆動用IC7が接着層31によって第1液晶用基板13上に接着される。そしてその接着層31は、接合剤としてのACF（Anisotropic conductive film：異方性導電膜）32及びそのACF32の内部に形成された複数個の空間33によって構成される。ACF32は、接着性樹脂フィルムの中に多数の導電粒子34を分散させることによって形成されており、IC7の出力用バンプ28が導電粒子34を介して透明電極18に電気的に接続され、他方、入力用バンプ29が導電粒子34を介して半導体入力用端子21に電気的に接続される。また、バンプ28、バンプ29及び各端子間は、接着性樹脂によって絶縁状態に保持される。

第2図は、第1図において矢印Aで示す方向から液晶駆動用IC7の接合部分を見た状態を示している。この図から明らかのように、複数の空間33は、長手方向に2列に並べられたバンプ28、29と、短手方向に2列に並べられたバンプ28、28とによって囲まれる領域内、すなわち環状に配列された複数のバンプ28、29によって囲まれる領域内に互いに近接した状態で位置している。なお、第2図においてはバンプ28、及び29を省略して記載しているが、基板の周辺端部にバンプが図示されているのと同様に形成されていることを補足してお

く。

一般に、液晶駆動用IC7を基板13上に接合する際には、液晶駆動用IC7と基板13との間にACF32を挟んだ状態でIC7を加熱しながら基板13に所定圧力で押し付ける。このとき、ACF32はエポキシ系の接着剤により形成することが好ましい。特に、エポキシ基を含む分子を比較的低分子量にして形成することにより、優れた接着特性を有することができる。

この加熱及び加圧処理の際、液晶駆動用IC7は反りを生じることがあり、そのような反りが発生すると、バンプ28及び29の接続部に過剰な応力が発生して電気的な接続状態が不安定になるおそれがある。また、液晶駆動用IC7に温度変化が生じるときにも、そのIC7及び／又は基板13が変形することによってバンプ28及び29の接続状態が不安定になるおそれがある。

これに対し、本実施形態のようにACF32の内部に空間33を設けておけば、液晶駆動用IC7が変形するときには、その変形に従ってそれらの空間33が自由に変形してそのIC7の変形を吸収でき、その結果、バンプ28及び29の接続部分に過剰な応力が発生することを防止できる。

ACF32の内部に空間33を形成するための方法は特定の方法に限定されないが、例えば、液晶駆動用IC7を基板13に圧着する際の圧着条件を使用する液晶駆動用IC7に対応した適切な条件に設定することにより、そのような空間33を得ることができる。そのような圧着条件の一例として次のような条件が挙げられる。

(1) 液晶駆動用IC7 : SED1220 (セイコーエプソン株式会社製)

このICの形状は、第2図において、 $L \times W = 7.7 \text{ mm} \times 2.8 \text{ mm}$ であり、バンプ数は約200個であり、バンプサイズは $80 \mu\text{m} \times 120 \mu\text{m}$ である。

(2) ACF32 : CP8530 (ソニーケミカル株式会社製)

(3) ACFの加熱温度: $180 \sim 230^\circ\text{C}$ (中心温度= $200 \sim 210^\circ\text{C}$) IC7を高温に加熱された加圧ヘッドで押し付けることによりACFを加圧及び加熱する場合には、その加圧ヘッドの温度を $260 \sim 360^\circ\text{C}$ (中心温度= 300°C 程度) とすることにより、上記のACFの温度が得られる。

(4) 加圧ヘッドの加圧力: $12 \text{ kgf} \sim 20 \text{ kgf}$

(5) 加圧ヘッドの加圧時間：10秒

以上の(1)～(5)の条件の下に液晶駆動用IC7を基板13上に接合したところ、第2図に示すような複数の空間33がACF32の内部に形成された。

この空間は、加熱及び加圧処理の際、初期の段階(0.1～0.5秒程度の段階)の加熱の際、接着剤の粘度が急激に低下し、半導体素子の外側に接着層の一部が流れ出し、それによってACFの中に形成される。ACFの中に占める空間の割合は5%～70%の範囲が好ましい。これは、空間が5%未満の場合、ACFに係る応力を吸収することができない。逆に空間が70%を越えた場合、空間の占める割合が多すぎるため、端子(もしくは電極)同士を信頼性高く接続することができない。従って、この範囲に空間の割合を設定することが好ましいが、特に信頼性高く接続するためには、空間の割合を10～30%の間に設定することが好ましい。この範囲に設定することにより、接着強度を落とすことなく、また同時に内部応力を緩和することができるため、信頼性の高い接続を達成することができる。

第7図は、空間33の設け方についての変形例を示している。この変形例が第2図に示した先の実施形態と異なる点は、長手方向のバンプ列28, 29の間及び短手方向のバンプ列28, 28の間に空間33を設けるだけでなく、個々のバンプの間及び一対のバンプ列の外側に空間33を設けたことである。空間33をこのように配置した場合でも、基板に対する半導体素子の接続状態を安定に保持できる。なお、第7図において、バンプ28及び29が省略されて記載されているが、基板端部の周囲には図示されているバンプ28や29と同様なバンプが形成されている。一点鎖線で示されているのがバンプである。なお、第8図、もしくは第2図についても同様に、バンプを省略して記載してあるが、図示されているバンプ28及び29と同様のバンプが基板単部周囲に形成されている。

第8図は、バンプ配列に関する変形例を示している。この変形例が第2図に示した先の実施形態と異なる点は、複数のバンプ28, 29を環状に配列するのではなくて、長手方向に関してだけ列状に配列した点である。この変形例では、バンプ列28, 29の間に複数の空間33を設けてあるが、これに代えて又はこれに加えて、個々のバンプの間及び／又はバンプ列の外側に空間33を設けること

もできる。

以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した技術的範囲内で種々に改変できる。

例えば、本発明に係る半導体の接続構造及び液晶表示装置は、携帯電話機以外の電子機器、例えば、ナビゲーションシステム、テレビ、パームトップコンピュータ、電子手帳等といった、可視情報の表示を必要とする各種の機器に対して使用できる。

第3図～第5図に示した実施形態は、COG (Chip On Glass) 型液晶表示装置に本発明を適用した場合の実施形態であるが、本発明はそれ以外の形式の液晶表示装置、例えばCOB (Chip On Board) 型液晶表示装置等に対しても適用できる。

また、第3図～第5図に示した実施形態では、電子機器としての携帯電話機側の出力用端子6と液晶パネル8側の入力用端子21とを弾性体コネクタ12によって電気的に接続したが、両者を接続するための接続方法はこれに限られない。例えば、FPC (Flexible Printed Circuit) を用いて両端子を接続する場合も本発明に含まれる。

また、第1図の実施形態では、接着層31を導電粒子34を含むACF32によって構成したが、これに代えて、導電粒子を含まない接着剤を用いて構成することもできる。この場合には、その接着剤の内部に空間33が形成される。またこの場合には、液晶駆動用IC7のバンプと液晶パネル側の電極端子とが直接に接続される。

請 求 の 範 囲

- (1) 基板上に半導体素子を接続する半導体素子の接続構造において、基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層を有しており、
その接着層は、基板と半導体素子とを接合する接合剤と、その接合剤の内部に形成された空間とを有することを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (2) 請求項1記載の半導体素子の接続構造において、
半導体素子は列状に並べられた複数のバンプを有し、そして上記空間は、それらのバンプ列の間、それらのバンプ列の外側及び個々のバンプの間又はそれらの少なくともいずれか1つの領域内に形成されることを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (3) 請求項1又は請求項2記載の半導体素子の接続構造において、上記空間は、複数個の空間を互いに近接して配置することによって構成されることを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (4) 請求項1から請求項3のうちのいずれか1つに記載の半導体素子の接続構造において、接合剤は、樹脂フィルムの中に導電粒子を分散させて形成した異方性導電膜であることを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (5) 請求項1に記載の半導体素子の接続構造において、
前記接着剤中に占める前記空間の割合が5%～70%であることを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (6) 請求項5に記載の半導体素子の接続構造において、
前記接着剤中に占める前記空間の割合が10%～30%であることを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (7) 請求項1に記載の半導体素子の接続構造において、
前記接着層がエポキシ系の接着剤からなることを特徴とする半導体素子の接続構造。
- (8) 基板上に半導体素子を接続する半導体素子の接続構造において、基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層を有しており、
その接着層は、半導体素子又は基板の変形を吸収する作用を有することを特徴とする半導体素子の接続構造。

(9) 基板上に半導体素子を接続する半導体素子の接続方法において、基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層を介在させ、高温に加熱された加圧ヘッドで前記半導体素子を押し付けることにより前記接着層を加圧及び加熱し、前記基板と半導体素子とを接続するとともに、前記接着層の中に空間を形成することを特徴とする半導体素子の接続方法。

(10) 請求項9に記載の半導体素子の接続方法において、前記接着層がエポキシ系の接着剤からなることを特徴とする半導体素子の接続方法。

(11) 液晶を挟んで互いに対向する一対の液晶用基板と、少なくとも一方の液晶用基板上に接続される半導体素子と、液晶用基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層とを有する液晶表示装置において、

上記接着層は、液晶用基板と半導体素子とを接合する接合剤と、その接合剤の内部に形成された空間とを有することを特徴とする液晶表示装置。

(12) 請求項11記載の液晶表示装置において、半導体素子は列状に並べられた複数のバンプを有し、そして上記空間は、それらのバンプ列の間、それらのバンプ列の外側及び個々のバンプの間又はそれらの少なくともいずれか1つの領域内に形成されることを特徴とする液晶表示装置。

(13) 請求項11又は請求項12記載の液晶表示装置において、上記空間は、複数個の空間を互いに近接して配置することによって構成されることを特徴とする液晶表示装置。

(14) 請求項11から請求項13のうちのいずれか1つに記載の液晶表示装置において、

接合剤は、樹脂フィルムの中に導電粒子を分散させて形成した異方性導電膜であることを特徴とする液晶表示装置。

(15) 請求項11に記載の液晶表示装置において、前記接着剤中に占める前記空間の割合が5%～70%であることを特徴とする液晶表示装置。

(16) 請求項15に記載の液晶表示装置において、前記接着剤中に占める前記空間の割合が10%～30%であることを特徴とする

液晶表示装置。

(17) 複数の半導体駆動用出力端子と、それらの半導体駆動用出力端子に接続される液晶表示装置とを有する電子機器において、

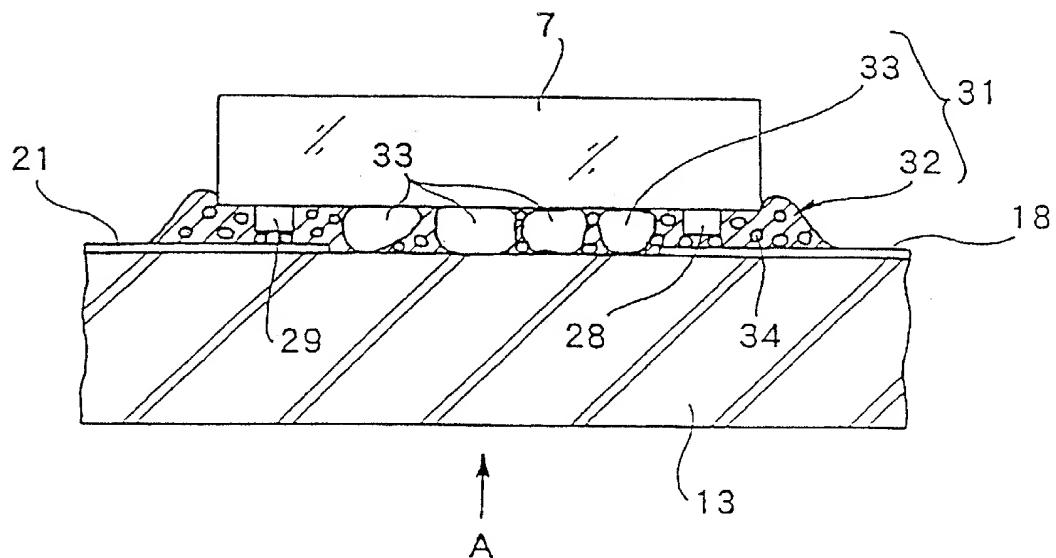
上記液晶表示装置は、液晶を挟んで互いに対向する一対の液晶用基板と、少なくとも一方の液晶用基板上に接続される半導体素子と、液晶用基板と半導体素子との間に介在して両者を接着する接着層とを有しており、そして

上記接着層は、液晶用基板と半導体素子とを接合する接合剤と、その接合剤の内部に形成された空間とを有することを特徴とする電子機器。

要 約 書

基板13上に半導体IC7を接続する半導体素子の接続構造において、基板13と半導体IC7との間に介在して両者を接着する接着層31を設ける。この接着層31は、基板13と半導体IC7とを接合する接合剤としてのACF32と、そのACF32の内部に形成された空間33とを有する。IC7が熱等のために変形してもその変形は空間33によって吸収され、よって、バンプ28, 29の接続状態が不安定になることがない。

第1図



第2図

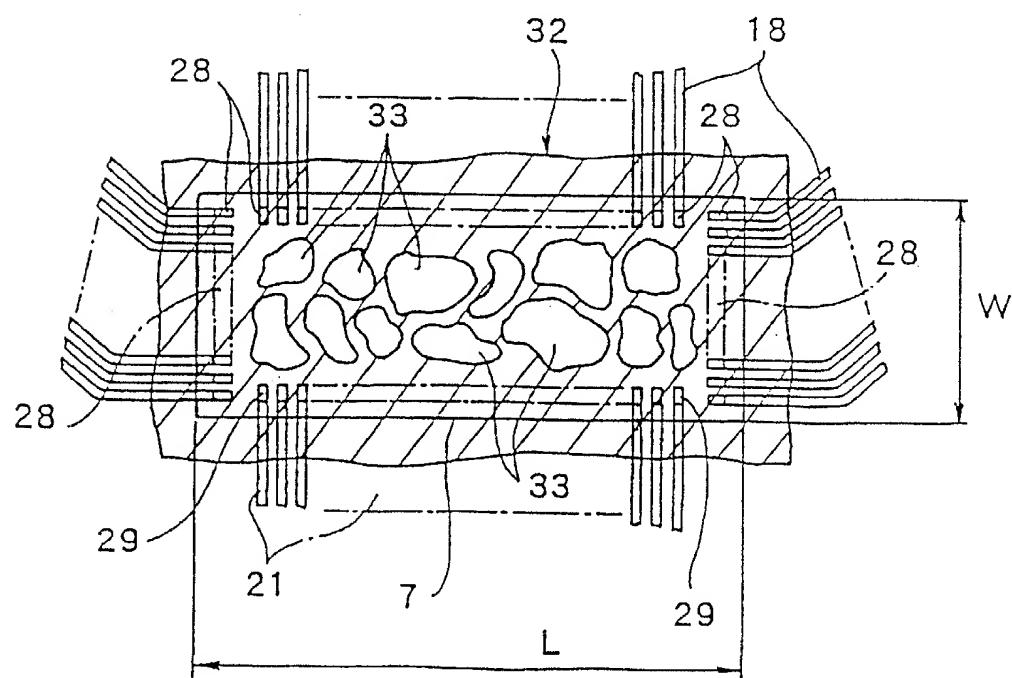
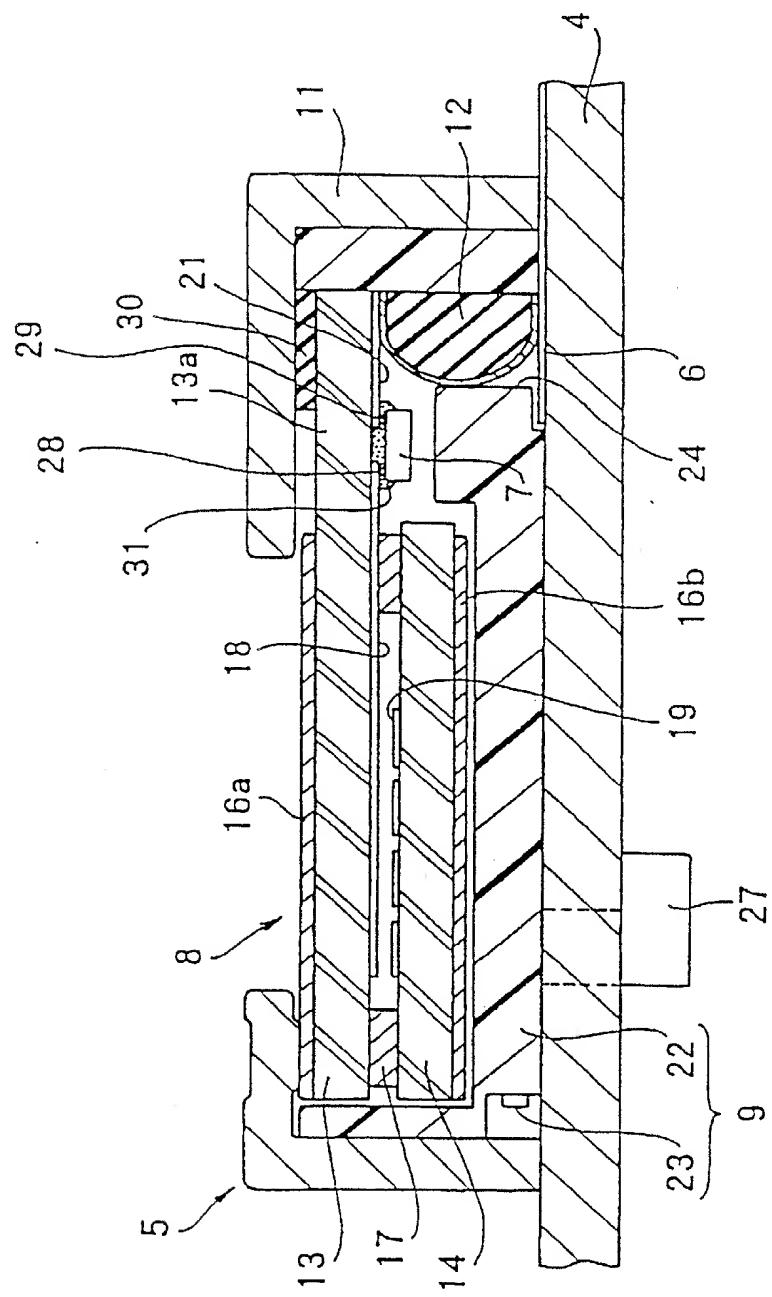
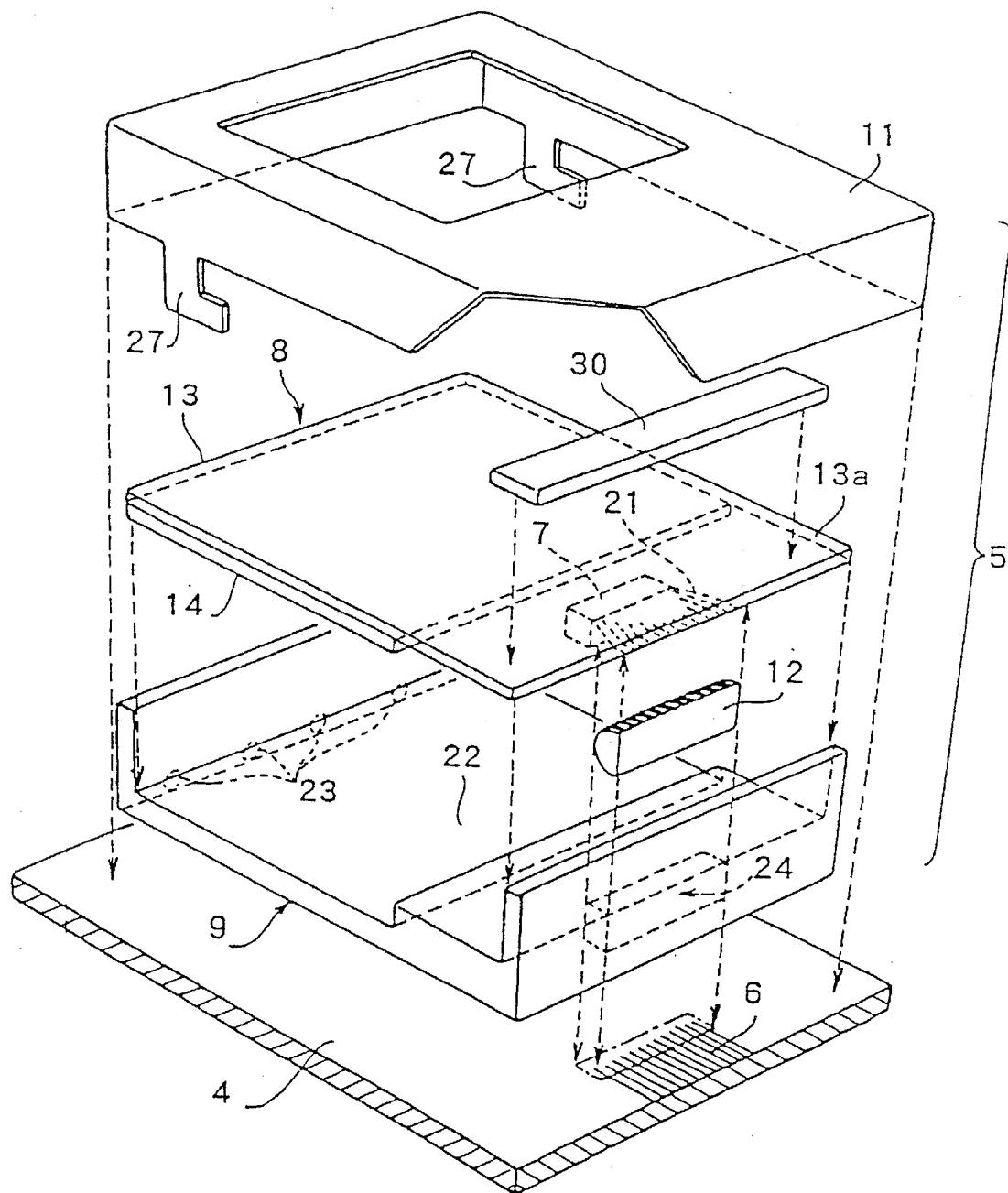


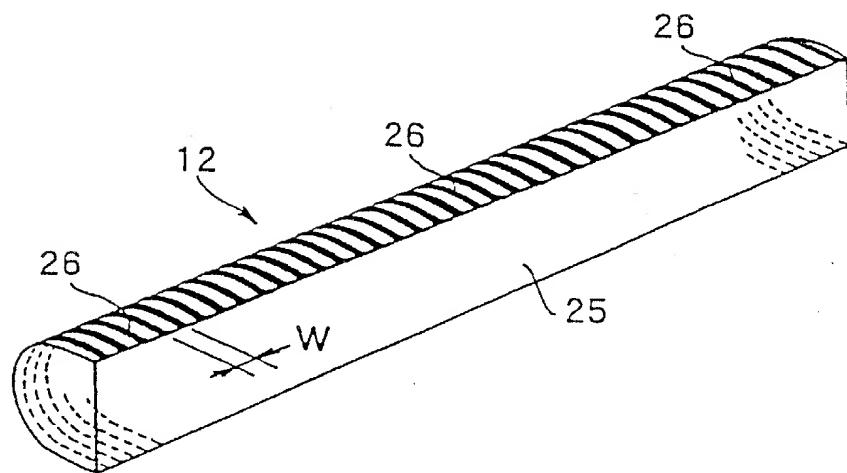
図3



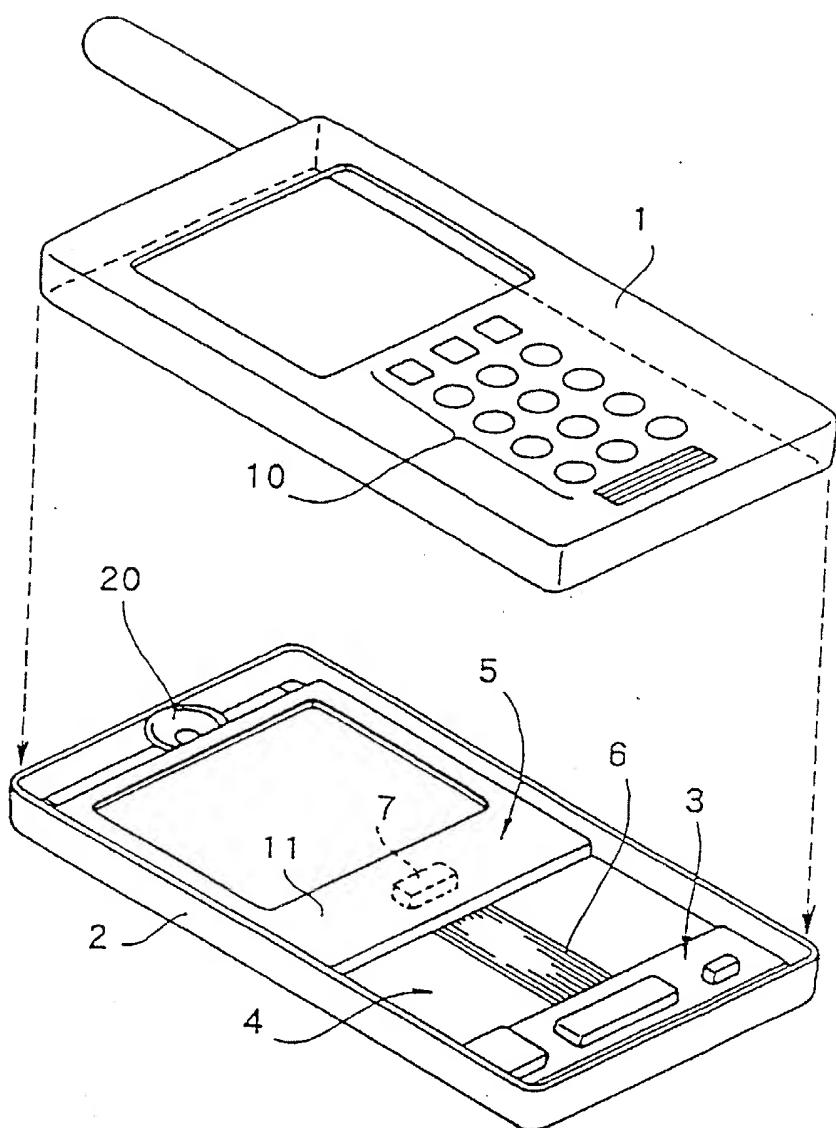
第4図



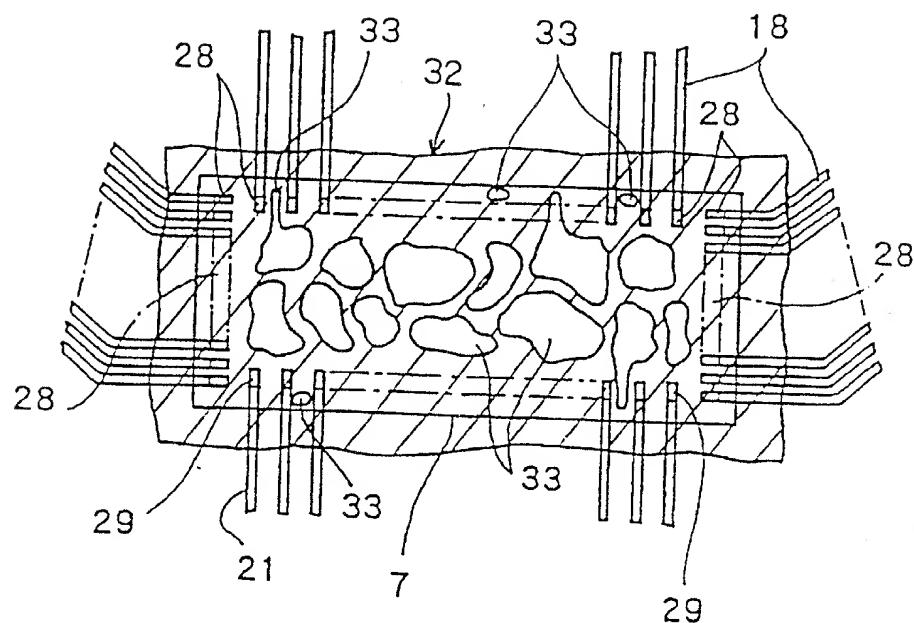
第5図



第6図



第7図



第8図

